有机硅导热灌封胶、高导热灌封胶、导热灌封ab胶

产品名称	有机硅导热灌封胶、高导热灌封胶、导热灌封ab胶
公司名称	深圳市鑫威灌封胶电子材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区西乡镇固戍新屋园新村2号8楼
联系电话	0755-33884138 13417396747

产品详情

产品特点及应用：

鑫威905是一种低粘度双组分加成型有机硅导热灌封胶，可以室温固化，也可以加热固化，具有温度越高固化越快的特点。本品在固化反应中不产生任何副产物，可以应用于PC(Poly-carbonate)、PP、ABS、PVC等材料及金属类的表面。适用于电子配件绝缘及防水。完全符合欧盟ROHS指令要求。

二、典型用途：

1、大功率电子元器件

2、散热和耐温要求较高的模块电源和线路板的灌封保护。

三：使用方法

1、混合前，首先把A组分和B组分在各自的容器内充分搅拌均匀。

2、混合时，应遵守A组分： B组分 = 10：1的重量比。

3、一般而言，20mm以下的模压可以模压后自然脱泡，因为温度高造成固化速度加快或模压深度较深，所以可根据需要进行脱泡。这时为了除去模压后表面和内部产生的气泡，应把混合液放入真空容器中，

在0.08MPa下至少脱泡5分钟。

4、应在固化前后技术参数表中给出的温度之上采用相应的固化时间，室温或加热固化均可。胶的固化速度受固化温度的影响，在冬季需很长时间才能固化，建议采用加热方式固化，80～100°C下固化15分钟，25°C室温条件下一般需8小时左右固化。

！！以下物质可能会阻碍本产品的固化，或发生未固化现象，所以，最好在进行简易实验验证后应用，必要时，需要清洗应用部位。

◆不完全固化的缩合型硅酮　◆ 胺(amine)固化型环氧树脂

◆白蜡焊接处理(solder flux)　◆ 锡、有机锡及含有有机锡的橡胶